

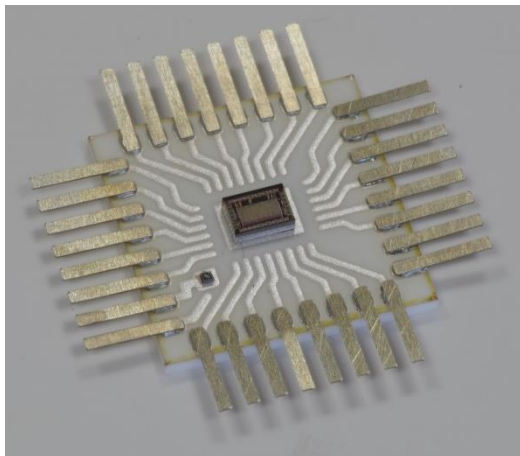
## PRODUKTOVÝ LIST - 003

OZNAČENÍ:

**Hybridní pouzdro**

TYP:

**CE4**



**Substrát**

Rozměr: 12,7 x 25,4 mm

Materiál: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

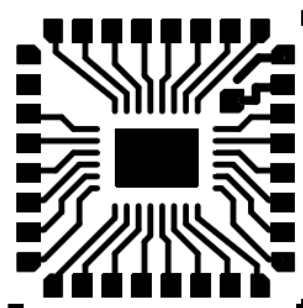
**TYPY**

Motiv potisku se liší podle typu pouzdra především velikostí střední plochy a počtem vývodů.

### POPIS:

Hybridní SMD pouzdro je realizováno potiskem stříbrnou TLV pastou na keramický substrát Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Pouzdro je osazeno vývodovými pásky s roztečí 1 mm. Z rubové strany je pouzdro opatřeno vrstevným topným odporem, jenž je možné využít k vyhřívání pouzdra v rozsahu od teploty okolního prostředí do teploty 120 °C. Měření teploty je realizováno pomocí měření úbytku napětí na polovodičovém přechodu tranzistorového čipu, který je umístěn v blízkosti střední plochy na lícové straně pouzdra. Pouzdro umožňuje připojení až 32 vývodového čipu.

### TOPOLOGIE:



CE4